COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES FÍSICAS

Eliminadores de flux

Formulaciones para ensamblajes electrónicos

Hoja genérica de referencia. La formulación y los valores contractuales se concretan para el producto, el uso, el mercado y el territorio de destino.

1. Identidad y composición de referencia

Disolventes o formulaciones acuosas según flux · Tensioactivos y auxiliares cuando proceda

Las alternativas descritas no constituyen una receta acumulativa. Cuando se trata de una mezcla, las proporciones, impurezas y aditivos corresponden a una referencia identificada; no se asigna una pureza del 100 % a partir del nombre comercial o de la familia.

2. Propiedades físicas y comportamiento

Parámetro	Dato / descripción	Condición y alcance
Estado / aspecto	Líquido o aerosol	Descripción de la familia.
Comportamiento en agua	Solubilidad del residuo y aclarado dependen de la química del flux y del limpiador.	Evaluación con el agua y las condiciones del proceso.
pH / acidez / alcalinidad	Valor de la referencia	En sólidos, indicar concentración de la dispersión o solución. En productos no acuosos, pH puede no ser aplicable.
Densidad / viscosidad	Valor a temperatura de ensayo	Distinguir densidad real, aparente y relativa; la viscosidad requiere método y, si procede, cizalla.

Los datos numéricos identificados como ejemplo de grado o dato de sustancia son referencias técnicas, no resultados de lote. Las magnitudes sin cifra única dependen de la formulación y del método indicado.

ESPECIFICACIÓN Y CONTROL

Eliminadores de flux

3. Variantes y función

Limpiadores acuosos, semiaqueosos o con disolventes para residuos de ensamblaje. Retirar residuos de soldadura compatibles con el proceso de limpieza.

Determinación	Criterio técnico y forma de expresión
Residuo	Tipo de flux y condición tras soldadura.
Química	Compatibilidad con el flux, la placa y los componentes.
Método	Limpieza manual, aspersión, inmersión u otro proceso definido.
Control iónico	Residuo iónico superficial por método apropiado.
Secado	Evaporación o enjuague y secado, especialmente bajo componentes.
Preparación posterior	Compatibilidad con coating, encapsulado o adhesión.

4. Control en el proceso

Validar sobre la placa real y zonas de difícil acceso. «No clean» no significa que el residuo sea compatible con cualquier recubrimiento posterior.

5. Compatibilidad

Comprobar etiquetas, plásticos, barnices y componentes sensibles. La inspección visual sola puede no detectar contaminación iónica.

6. Presentación y documentación del lote

El certificado de análisis identifica lote, determinación, método, unidad, límite y resultado. No se transforma un intervalo orientativo en una tolerancia contractual sin identificar el grado.